

证券代码：002156

证券简称：通富微电

公告编号：2009-041

南通富士通微电子股份有限公司 与株式会社东芝、东芝半导体（无锡）有限公司 签署合作备忘录的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为了进一步扩大规模、促进企业进步，我公司于 2009 年 11 月 19 日与株式会社东芝（以下简称“日本东芝”）、东芝半导体（无锡）有限公司（以下简称“无锡东芝”）就共同成立合资企业签署了合作备忘录。我公司和无锡东芝将共同设立一家新合资企业，从事 LSI 系统和分立器件的封装和测试，及其附随的或必要的其他相关业务。新合资企业的注册资本约为 10 亿日元（折合人民币约 7,650 万元），无锡东芝出资 80%，我公司出资 20%，出资方式为设备资产和现金投入。根据合资公司的经营状况，今后几年双方将就调整我公司在合资公司的出资比例、由我公司控股合资公司等事宜进行充分讨论。双方计划明年 1 月份签订正式合同，4 月份成立合资公司。

无锡东芝是日本东芝的全资子公司，也是其在中国的后道基地。无锡东芝于 2002 年 7 月在无锡高新技术产业开发区成立，注册资本 28 亿日元，主要开发、设计、检测和销售大规模集成电路和其他半导体产品。截至 2009 年 10 月底，拥有员工约 400 人。

此次与无锡东芝共同成立合资公司后，我公司将成为日本东芝在后道外包事业的重要合作伙伴和其在中国的战略合作伙伴，对我公司成为世界集成电路行业高端领域专业的封装测试服务提供商将会起到积极的作用。此次合作对公司近期业绩的影响将根据合资公司运行情况以及日本东芝与我公司的业务计划而定。

该备忘录表达了各方的合作意向，具体合作事宜有待于我公司召开董事会审议

批准以及无锡东芝履行相应的内部审批程序，并通过签署正式合同的方式确定。我
公司将根据合作进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

南通富士通微电子股份有限公司董事会

2009年11月19日